

INVESTOR RELATIONS

2021년 1분기

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

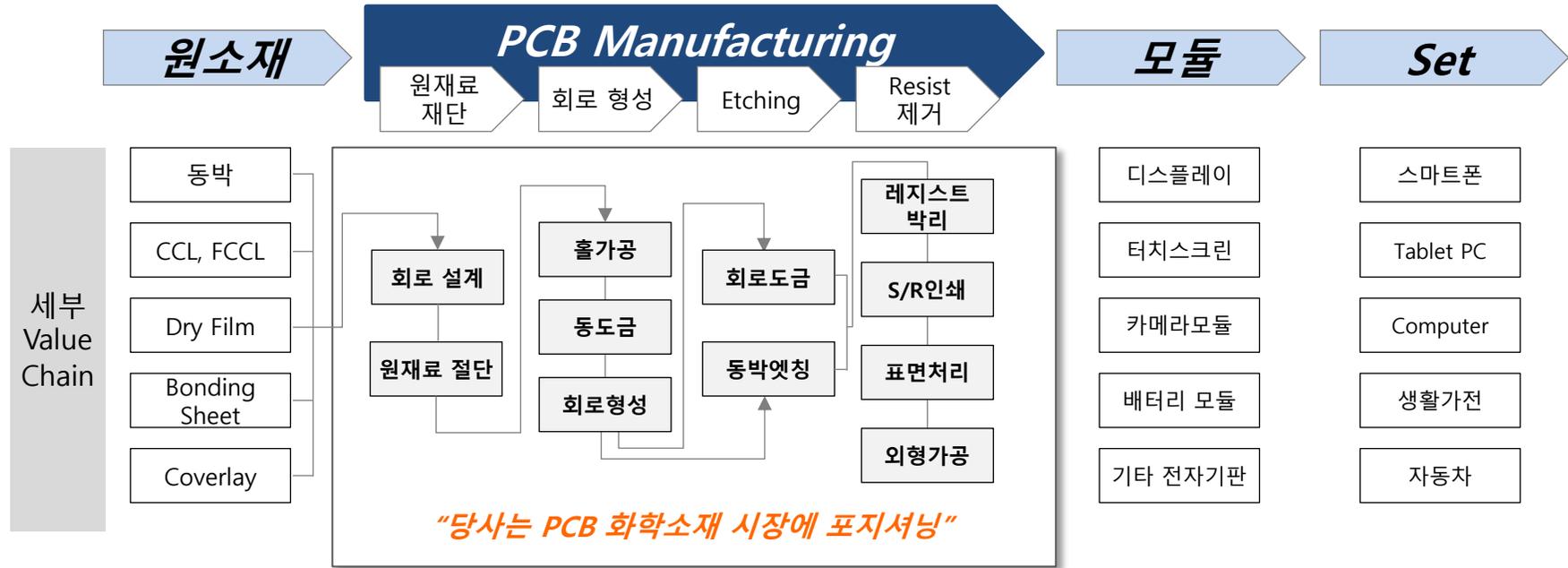
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대중”

FPCB Customer				
				
				
PKG Substrate				

Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정, 박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다. 이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



Final Finishing Chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

ENEPIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

EPIG process

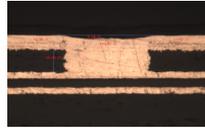
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

Immersion process

- ✓ PROTIN Series

Electrolytic gold process

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

Electrolytic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



Process Chemical

DES Chemical

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

Gold Recover

UBM Etchant

LAZ Process



New product for 5G

No etching and roughness laminating pretreatment

Ultra low profile detachable thin copper foil

Positive Cu roughening

Process Nanotus®

Electroless Copper plating for LCP

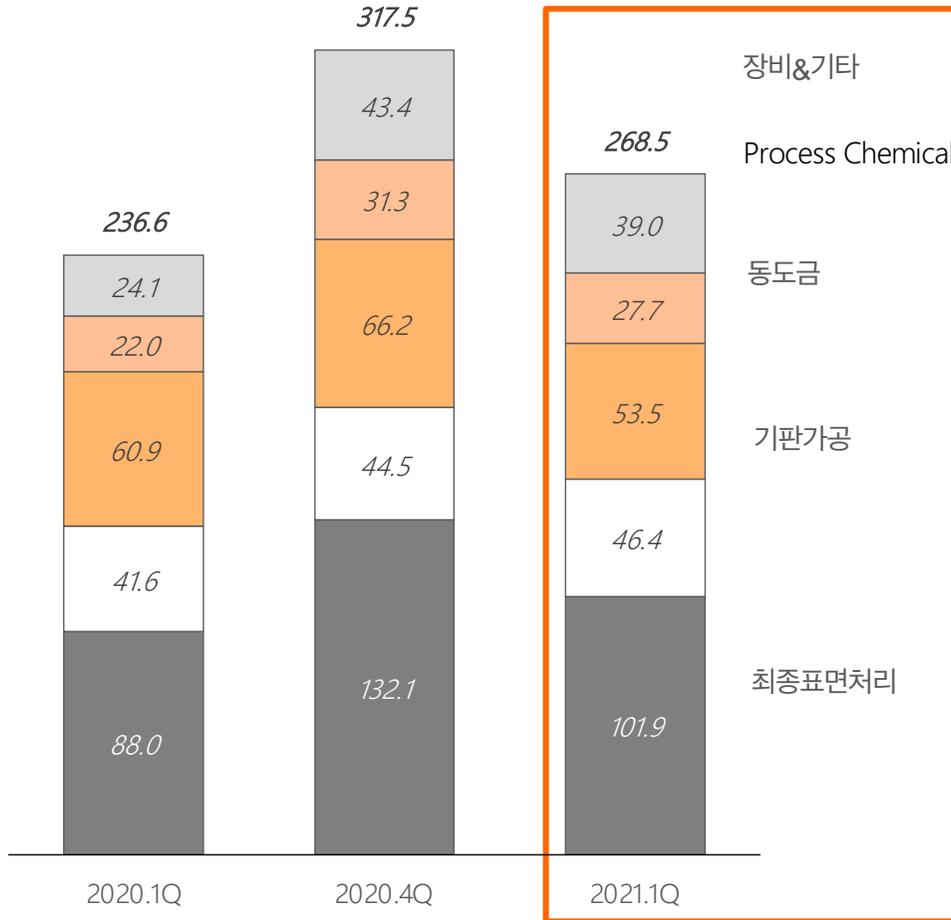
Domestic Market situation

신규 사업분야
기존 사업분야

		"기존 사업영역"		"21년 신규진입분야"					
		FPCB, RFPCB		PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> SEMCO BH Flex Youngpoong Daeduck 		<ul style="list-style-type: none"> SEMCO Daeduck SIMTECH Korea Circuit 		<ul style="list-style-type: none"> Daeduck LG Innoteck Korea Circuit 		<ul style="list-style-type: none"> Hyunwoo SEIL 	
	Global	<ul style="list-style-type: none"> Zhending Technology Career Unimicron Mektron 		<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 		<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 		<ul style="list-style-type: none"> Various 	
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> 점유율 확대중 Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션 		<ul style="list-style-type: none"> 고객사 및 라인 확대중 		<ul style="list-style-type: none"> 박리 / 에칭 관련 매출 확대중 		<ul style="list-style-type: none"> - 	
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> 국내 높은수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정) 		<ul style="list-style-type: none"> 20년 Major 고객사 진입 21년 고객사 수 확대중 		<ul style="list-style-type: none"> 국내 HDI 업체 프로모션 중 		<ul style="list-style-type: none"> - 	
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> 외주를 통한 양산 		<ul style="list-style-type: none"> 현재 자회사 외주를 통한 매출발생중 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> - 	
최종표면처리	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> 금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상) 		<ul style="list-style-type: none"> 고객사 평가중 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> 일부 국내 고객사 거래중 	
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> 베트남 시장 전해금도금 외주물량 확대 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 		<ul style="list-style-type: none"> Developing 	

Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process Chemical □ 기타 및 장비 (단위:억원)



- **21년 1Q 매출액 268.5억원으로 1분기 중 역대 최대 매출 달성**
 - ✓ 20년 1Q 대비 31.9억원 / 13.48% 성장
- **Chemical 제품군의 지속적인 성장**
 - ✓ 최종표면처리 : 중국 시장 카메라모듈용 도금약품의 매출확대, 비트코인 채굴용 그래픽 카드 확대에 따른 중국시장 PCB 물량 증가
 - ✓ 동도금 : FPCB 및 PKG 업체의 꾸준한 증가, 전년 동기 대비 물량감소로 소폭 감소하였으나, 연간 단위로는 성장 전망
 - ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 대비 매출 상승
- **베트남 법인의 매출 및 이익 확대**
 - ✓ 20.1Q 30억원 → 21.1Q 61.4억원 성장
 - ✓ 국내 FPCB 고객사의 물량이 베트남으로 이전됨에 따라 베트남 법인의 약품 매출 확대

신규사업 & 투자 진행현황

소재사업 (동박 & OLED 소재)

- Main Application 시장인 PKG Substrate 용 극동박은 현재 개발 중으로 현재 해당 시장은 일본 1개 회사 독점 중. 당사는 국책과제 및 소부장 100 선정으로 해당 시장 진입을 위해 제품 개발 중. 23년 양산 목표
- OLED 관련 소재는 20년 말 조직을 구성하여 현재 개발중에 있으며 장기적인 개발 과제

구리원단

- 당사의 원단은 항균성능, 살균성능, 유해물질, 코로나바이러스등 관련 인증서는 모두 획득, 현재 초단위 / 분단위 테스트를 진행중에 있음.
- 조직구성 완료 / 법인 설립중으로 하반기 제품 출시 예정

중국 Zuhai 공장

- 21년 말 완공예정으로 현재는 판매법인 이지만 22년 생산법인으로 전환, 약품 양산 예정
- 약품 제조에 더하여 현재 한국 및 베트남에서 진행중인 기판가공 사업 진행

Income Statement

(단위:억원)

	제 23기 1분기	매출비중	제 22기 1Q	매출비중
I. 매출액	268.5	100%	236.6	100%
II. 매출원가	186.5	69.4%	157.4	66.5%
III. 매출총이익	82.0	30.6%	79.2	33.5%
판매비와 관리비	36.0	13.4%	38.6	16.3%
IV. 영업이익	46.0	17.2%	40.6	17.2%
금융수익	20.2	7.5%	16.7	7.1%
금융비용	5.4	2.0%	6.0	2.6%
기타수익	1.3	0.4%	0.3	0.1%
기타비용	0.1	0.0%	1.0	0.4%
지분법손익	-	-	-0.5	-0.2%
V. 법인세차감전순이익	62.0	23.1%	50.1	21.2%
법인세비용	14.2	5.3%	11.5	4.9%
VI. 당기순이익	47.8	17.8%	38.6	16.3%

주요 수익성 지표

	제23기 1분기	제22기 1분기
영업이익률	17.2%	17.2%
순이익률	17.8%	16.3%
EBITDA (마진율)	62.1 (23.15%)	54.6 (23.07%)
ROE	3.6%	3.7%

Balance Sheet

(단위:억원)

	제 23기 1분기	제 22기 1분기
자산		
현금성자산	584.6	435.1
매출채권	262.5	263.6
유형자산	765.7	620.3
기타자산	412.9	347.6
자산총계	2,025.7	1,666.6
부채		
매입채무	30.1	38.5
차입금	490.6	324.5
전환사채	125.4	143.3
기타부채	136.7	206.3
부채총계	782.8	712.6
자본		
자본금	74.8	37.0
자본잉여금	249.4	218.6
이익잉여금	711.1	560.9
기타자본	207.6	137.5
자본총계	1,242.9	954.0
부채와 자본계	2,025.7	1,666.6

Cash Flow

(단위:억원)

	제 23기 1분기	제 22기 1분기
기초현금	556.4	417.5
영업활동으로 인한 현금흐름	25.9	50.0
순이익	47.8	38.6
감가상각비	16.1	13.9
법인세비용	14.2	11.5
외화환산이익	(15.3)	(12.7)
자산부채의 변동	(37.6)	7.2
투자활동으로 인한 현금흐름	(8.0)	(19.1)
유형자산의 증가	(11.3)	(17.1)
재무활동으로 인한 현금흐름	(7.6)	(21.8)
차입금 증감	(5.7)	(20.1)
현금증감	10.3	9.1
환율변동효과	17.8	8.5
기말현금	584.5	435.1